

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年11月8日业绩说明会)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	通过线上方式参与公司2024年三季度业绩说明会的投资者
活动时间	2024年11月8日（周五）10:00-11:00
活动地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	蒋学明先生（董事长） 谢莺霞女士（董事、总经理） 蒋雨舟女士（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（代行职务）） 陈丽萍女士（独立董事）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年11月8日10:00-11:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2024年三季度业绩说明会。公司管理层与投资者进行了线上交流，具体情况如下：</p> <p>1、研发费用增长比较明显，未来的研发费用是否会持续增长？ 答：公司坚持技术创新，报告期内公司研发投入5,220.56万元，同比增长21.29%，公司前三季度研发费用15,797.11万元，同比增长24.60%。公司一方面坚持自主研发，在中小容量存储芯片领域继续保持高水平研发投入，不断丰富产品线，推进产品制程迭代，提高产品可靠性水平。另一方面，为进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局。未来公司将持续保持高水平研发投入，强化基础技术的研发，不断提升技术创新能力，增强技术领先性，积累核心技术优势。</p> <p>2、公司在主要产品线（如NAND、MCP、DRAM、NOR等）的市场表现如何？哪些产品线的增长最为显著？公司在这些产品线上的市场份额有何变化？公司采取了哪些市场策略来推动增长？ 答：随着存储市场的逐步复苏，公司的存储产品线出货量均有所增长，主要营收增长贡献来源于公司的主力产品SLC NAND。需求方面伴随着网通需求的逐步修复，主要运营商针对FTTR方案的大力推广，监控安</p>

防以及可穿戴需求维持上半年的稳定态势，公司三季度营收环比向上，业绩逐步修复。公司坚持以各行业头部客户为核心，不断进行市场开拓，提高公司在各个下游应用领域的市场份额。

3、东芯股份未来在技术研发方面的重点方向是什么？公司是否有计划推出新的存储芯片产品或技术？这些新产品或技术预计何时能够上市，对公司未来业绩有何预期影响？

答：公司将坚持独立自主研发，在中小容量存储芯片领域继续保持高水平研发投入，不断丰富产品线，推进产品制程迭代，提高产品良率，并将产品可靠性标准逐步向车规级推进，以顺应汽车产业在智能网联功能的布局，大力发展可靠性要求更高的车规级存储芯片；另一方面，公司将以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案。公司对新型存储技术保持持续关注。

4、公司新产品的研发进度如何？

答：报告期内，公司基于 2xnm 制程，持续进行 SLC NAND Flash 产品系列的研发，不断扩充产品线。公司坚持技术创新，努力推进公司产品制程迭代，公司先进制程的 1xnm SLC NAND Flash 产品的研发工作已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，为确保产品质量与性能稳定，目前正持续进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-1Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。随着公司 NOR Flash 产品持续迭代升级，产品品类不断丰富，将为可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子等领域的客户提供多样化、高可靠性的产品选择。目前公司的 DRAM 产品包括 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、PSRAM，以及正在进行客户送样及市场推广的 LPDDR4x。公司将继续在 DRAM 领域进行新产品的研发设计，助力公司产品多样性发展。公司目前已可以向客户提供高至 8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 的 MCP 产品，主要应用于车载模块等应用领域。公司将继续开发更高容量组合的 MCP 产品，以便为客户提供更多样化的产品选择。此外，公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，组建研发团队从事 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发，目前产品尚在研发阶段，进展顺利。

5、对于增加 Wifi7 产品线以及对砺算的投资，公司是出于怎样的考虑？

答：为应对存储行业的周期性波动，提升公司产品品类的多样化，优化业务布局，公司凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索。在 Wi-Fi 7 领域，公司新设立了子公司亿芯通感，研发团队拥有国际或国内的一线通信芯片大厂的研发经验。在 GPU 领域，公司对外投资了上海砺算，它是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业，具备建制制的研发团队，产品研发已处于流片前的准备阶段。以上业务布局，与公司的主营业务具有一定的协同性，有助于提升

	公司整体研发实力和核心竞争力，为客户提供更加多样化的芯片解决方案。
日期	2024年11月8日